

PCB加工工艺要求说明

1. 一般信息

- 1.0 主要技术联系人: 丁朝阳 电话: 13927497578
邮箱: zhaoyang.ding@hanputek.com 传真:
- 1.1 其他技术联系人: 戴康明 电话: 13714646123 邮箱: kangming.dai@hanputek.com
其他技术支持联系人: kangming.dai@hampoo.com
- 注意: EQ确认单问请抄送上述所有邮箱, 如一定时间内未回复, 请电话联系“主要技术联系人”, 以保证第一时间确认工程问题, 谢谢!

2. 工艺信息

- 2.0 板名: CRD30DD12N-K_30K_RevC 特殊板种类: 一般通孔板
- 2.1 层数: 4层 最小孔径(mm): 0.3048
- 2.2 基材: FR4 孔密度(个/平方米): 98829.88
- 2.3 厚径比: 5:1 最小线宽/距(mil): 5.00/3.00
翘曲度: $\leq 0.75\%$
- 2.4 单板(Unit)尺寸(mm): 100.00 X 55.00 拼板方式: 2 X 5
拼板(Set)尺寸(mm): 202.00 X 275.00 每拼板(Set)单板(Unit)数: 10 组成拼板的单板种数: 1
☒ V-CUT:
- 2.5 板厚(mm): 1.6 公差: $\pm 10\%$
- 2.6 阻焊: 双面印 颜色: 绿色 阻焊光面: 亮光
- 2.7 字符: 双面印 颜色: 白色
标记: ☐ UL
请不要在板内空白区域添加制板厂logo.
请在板内空白区域添加板子生产日期.
- 2.8 表面处理: 无铅喷锡 锡厚: 1-40um 镀金手指: ☒ 无 ☐ 有, 金厚:
金手指斜边: ☐ Yes ☒ No
板厚削薄边: ☐ Yes ☒ No
- 2.9 过孔阻焊处理方式: ☐ 除焊盘区域外整板塞孔 ☐ BGA区域塞孔, 其他按Gerber
☒ 整板过孔塞孔 ☐ 全部按Gerber 塞孔物质: 油墨
- 2.10 阻抗控制: ☐ Yes ☒ No
- 2.11 盲孔/HDI: ☐ Yes ☒ No
- 2.12 验收标准或规范: ☒ IPC-6012-II, current revision.
- 2.13 IPC网表对比: ☒ Yes ☐ No
- 2.14 交货附件: ☒ 电测报告 ☒ 出货检测报告 ☒ Gerber
☒ PCB切片报告(最小直径过孔及内/外层线路位置) ☒ 阻抗测试报告
☐ 其他
- 2.15 包装要求: ☒ 真空包装, ☒ 板间隔纸

3. 叠层设置

